

# 環境関連製品・技術

## 環境に配慮したグリーン製品・技術も、 私たちがおとどけするソリューションです。

富士通が提供する環境ソリューションは、@EcoVisionだけにとどまりません。

リサイクルや省エネルギーに優れた製品や、環境汚染物質を分解・除去する技術の開発も、お客さまの環境経営に対する提案の一つ。当社のグリーン製品・技術の一部を紹介します。

### グリーン製品



**Color Printia LASER XL-C3100**  
 ・国際エネルギースタープログラム適合  
 (低電力モード消費電力:20.2W)  
 ・使用済みトナーカートリッジの回収



**イメージスキャナ fi-4010CU**  
 ・国際エネルギースタープログラム適合  
 (低電力モード消費電力:4.4W)  
 ・25g以上プラスチック部品への材料表示

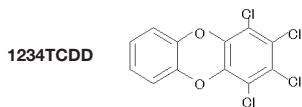


**PRIMEPOWER 600**  
 (ベDESTAL)

- ・省エネルギー法の2005年度目標基準値適合
- (エネルギー消費効率:0.23/F区分)
- ・再資源化可能率:97%

### プラズマ触媒融合技術により 高濃度ダイオキシンの分解に成功

富士通研究所は、財団法人ファインセラミックスセンターと共同で、プラズマ<sup>\*1</sup>と触媒<sup>\*2</sup>の融合技術により環境汚染物質の一つであるダイオキシン類ガス<sup>\*3</sup>を分解する技術を開発しました。処理能力の高いプラズマ分解法と比較して、100倍以上の高濃度ダイオキシン類ガスを無害化することが可能です。分解後の成分を分析した結果、毒性のある物質はまったく検出されませんでした。この技術は、日本およびアメリカで基本特許が成立しています。



実験に用いた「ダイオキシン類の中で毒性が認められていない物質」

### 環境に配慮したハロゲンフリー難燃性 ビルドアップ基板用絶縁材料を開発

ハロゲンや重金属を使用せず、材料に屈曲耐性<sup>\*4</sup>を持たせる構造設計を行うことにより、環境に配慮し、高多層配線基板にも適用可能なビルドアップ基板<sup>\*5</sup>用の絶縁材料を開発しました。ビルドアップ基板は従来、燃焼時に毒性の高い臭化水素や臭素化ダイオキシンの発生が懸念されるため、環境への配慮からハロゲンフリー化が望まれていました。この絶縁材料では、燃焼ガスの安全性が高い難燃剤を使用することで、ハロゲンフリー化を達成しています。



### ノートパソコンのボディに使用される、 マグネシウム合金の材料再生技術を開発

ノートパソコンのマグネシウム合金製ボディを成形する際、不要となった部分を溶解して成分を調整することで材料を再生するリサイクルプロセスを開発しました。これにより、すべてのマグネシウム合金材料を廃棄することなく使用できます。再生した材料を用いてノートパソコン用筐体を試作した結果、10回以上のリサイクルを行っても、初期材料を使用した場合と比べて遜色のない特性を示すことを確認しました。再生材料は、当社製品ですでに採用しています。

### 環境に配慮したLSI用の生分解性 エンボステープを開発

情報機器メーカーで初めて、ポリ乳酸系生分解性プラスチックを用いたLSI用のエンボステープを開発し、2000年より当社LSI製品に適用しています。このエンボステープは生分解性プラスチックを用いているため、埋め立て廃棄後に微生物によって水と二酸化炭素に分解されます。焼却する場合でも、木材同様に熱エネルギーが低いため、焼却炉の損傷を抑えることができます。

